

RDT-650

Coating
Naxau

Model RDT

复合集流体铜 / EMI显示镀铜膜

■ 双面同步蒸镀

一次走膜完成双面镀铜，产能翻倍，均匀性 $\leq \pm 3\%$

■ 低方阻高屏蔽

1 μm Cu方阻 $\leq 0.03\Omega/\text{sq}$ ，屏蔽效能 $\geq 60\text{dB}$

■ 超薄膜适用

适配 $< 10\mu\text{m}$ PET/PI，专有低张力走膜防褶皱

■ 在线黑化模块

一步完成镀铜+CuO黑化，反射率 $\leq 20\%$

应用



复合集流体铜



EMI屏蔽膜



显示镀铜膜



柔性电子

技术参数

应用：复合集流体铜/EMI镀铜膜 走带速度：5-30m/min

基材：PET/PI < 10 μ m 源功率：电子束30-300kW

镀层：高纯Cu $\geq$ 99.99% 方阻： $\leq$ 0.03 Ω /sq

镀膜方式：双面沉积 屏蔽效能： $\geq$ 60dB

镀层厚度：0.1-5 μ m 反射率： $\leq$ 20%

标准幅宽：650mm 附着力：百格5B

设备概述

Model R-DT650 是面向复合集流体铜和 EMI 显示镀铜膜的双面卷绕镀铜设备。集成蒸发/磁控溅射/离子束辅助工艺，标配基膜热管理、张力闭环、镀层质量闭环控制，在超薄膜塑料基材上双面沉积高纯铜层，可选在线CuO黑化。设备集成贴鼓式冷却辊与低张力走膜机构，适配<10 μ m超薄PET/PI基材，实现低方阻、高屏蔽、高附着，适用于复合集流体铜与EMI屏蔽膜的规模化生产。

行业痛点

复合集流体铜需要超薄、低方阻、无针孔；EMI显示镀铜膜要求高屏蔽、低反射、高附着。传统单面镀效率低、双面镀均匀性差。本设备通过双面同步蒸镀、在线黑化、低张力走膜，兼顾高产能与高均匀性，解决超薄基材易褶皱、附着力不足、屏蔽效能不达标等问题。



纳狮新材料股份有限公司

浙江省嘉兴市平湖经济开发区兴平二路1661号
邮编 314200

电话：0086 0573 8507 1366
传真：0086 0573 8507 1367

更多全球纳狮服务网点查询请点击

